

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 17 年 6 月 16 日 (2005.6.16)

【公開番号】特開 2002-286755 (P2002-286755A)  
 【公開日】平成 14 年 10 月 3 日 (2002.10.3)  
 【出願番号】特願 2001-86267 (P2001-86267)  
 【国際特許分類第 7 版】

G 0 1 R 1/073

G 0 1 R 31/26

H 0 1 L 21/66

【F I】

G 0 1 R 1/073 F

G 0 1 R 31/26 J

H 0 1 L 21/66 B

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 9 月 9 日 (2004.9.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板の表面に形成した凹部を埋める犠牲層を形成し、前記基板表面に多数のリードを、その先端が前記犠牲層上に至るまで並列に形成し、次いで、前記基板の裏面から前記犠牲層に至る切り目を入れた後、前記犠牲層を除去することを特徴とする、リードの先端が基板の端部から突出してなるプローブユニットの製造方法。

【請求項 2】

前記リードの形成前に、前記凹部以外の部分の前記基板上に形成された前記犠牲層を研磨により除去することを特徴とする請求項 1 に記載のプローブユニットの製造方法。

【請求項 3】

前記凹部の隅部は湾曲面であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のプローブユニットの製造方法。

【請求項 4】

基板に貫通孔を設け、前記貫通孔内全体に犠牲層を形成し、前記基板表面に多数のリードをその先端が前記貫通孔に充填された前記犠牲層上に至るまで並列に形成し、次いで、前記犠牲層を除去することを特徴とする、リードの先端が基板の端部から突出してなるプローブユニットの製造方法。

【請求項 5】

前記リードの形成前に、前記貫通孔以外の部分の前記基板上に形成された前記犠牲層を研磨により除去する請求項 4 に記載のプローブユニットの製造方法。

【請求項 6】

前記犠牲層が前記基板及び前記リードに対して選択的に除去可能な金属、樹脂または無機物からなるものであることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載のプローブユニットの製造方法。

【請求項 7】

めっき下地層を介し又は介さずに金属めっきにより前記犠牲層を形成することを特徴とする請求項 6 に記載のプローブユニットの製造方法。

**【請求項 8】**

紫外線が一部に照射されてなる化学切削性感光性ガラスからなる基板の表面に、紫外線未照射部分から、先端が紫外線照射部分上に至るまで多数のリードを並列に配置し、次いで、紫外線照射部分のガラスをエッチングして除去することを特徴とする、リードの先端が基板の端部から突出してなるプローブユニットの製造方法。